

概要

この通知は、すべてのザイリンクス デバイス ファミリのパッケージに使用するモールド コンパウンドおよびダイアタッチ エポキシの材料を変更し、統一することをお知らせするものです。新しい材料セットは、すでにザイリンクスの ROHS 準拠製品で使用されております。

変更内容

ザイリンクスでは、材料を標準化するため、すべての製造工場にて特定のパッケージの組み立て材料を統一して参ります。モールド コンパウンドおよびダイアタッチ エポキシ剤は、現行の材料から、弊社の ROHS 準拠品で使用された材料セットに移行致します。リード プレーティングおよびはんだボールの変更はありません。ROHS に準拠した新材料は、ハロゲンフリーで、JEDEC 規格 J-STD-020C の Moisture Sensitivity Level (MSL) 3 に該当し、難燃性基準 UL94 V-0 を満たしております。この材料変更によるデバイスのフィット、形状、機能への影響はありません。

該当製品

デジタイゼーション (XCDAISY) およびメカニカル (XCMECH) サンプルを含むすべてのザイリンクス製品で、表 1 に示すパッケージ (Q グレード品、ミリタリ製品を除く) は、ROHS に準拠した材料セットに変更されます。

表 1: パッケージごとの現在および変更後の材料

パッケージ タイプ	現在使用中の材料		ROHS に準拠した材料	
	ダイアタッチ エポキシ	モールド コンパウンド	ダイアタッチ エポキシ	モールド コンパウンド
BG 225/256/388/492/575/728	8510	SMT-B1 シリーズ	2300 シリーズ	G770 シリーズ
FG 256/320/324/400/456/ 484/556/676/900/1156	8510	SMT-B1 シリーズ	2300 シリーズ	G770 シリーズ
FT256	QMI596	SMT-B1 シリーズ	2300 シリーズ	G770 シリーズ
CS 144/280	QMI536	SMT-B1 シリーズ	2025 シリーズ	G770 シリーズ
CS 48/CP56/CP132	2300 シリーズ	EME7730	2300 シリーズ (変更なし)	G770
PQ 100/160/208/240	8361 シリーズ	MP8000CH4	3230	G700 シリーズ
HQ 160/208/240/304	8361 84-1LMIS シリーズ	MP8000CH4 7304 シリーズ	1076	G700 シリーズ
HT 144/176/280	JMI2500	7320CR	3230	G700 シリーズ
PD8	84-1 LMISR4	6300H	8390A	DMC2000HG
VO 8/20/24	84-1LMI シリーズ	KMC-184 シリーズ	8290 シリーズ	G700 シリーズ
SO 8/20/24	84-1LMI シリーズ	MP8000CH4	8290 シリーズ	G600 シリーズ

キーデータ

表 2 に、変更品のデートコードを示します。在庫品がなくなるまでは、変更前の製品と混在出荷されます。

表 2：パッケージごとの混在出荷開始

パッケージ タイプ	デートコード
BG 225/256/388/492/575/728	0609
FG 256/320/324/400/456/484/556/676/900/1156	0609
FT256	0601
CS 144/280	0601
CS 48/CP56/CP132	0601
PQ 100/160/208/240	0609
HQ 160/208/240/304	0609
HT 144/176/280	0609
PD8	0609
VO 8/20/24	0609
SO 8/20/24	0609

トレーサビリティ

次のトップマークは、パッケージのトレーサビリティを示します。デートコードは図 1 に示すように、パッケージのトップ マーキングに示されます。

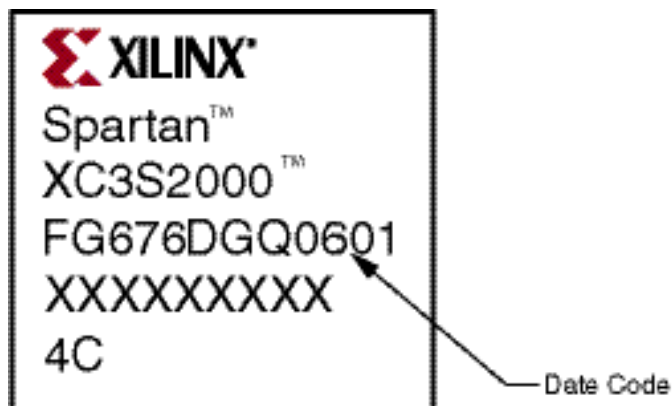


図 1：デートコードを示すラベル例

推奨

この通知に対する回答の必要はありません。

重要なお知らせ：カスタマ変更通知 (PCN、PDN、Quality Alert) は、弊社のサポート ウェブサイト <http://www.xilinx.co.jp/support/mysupport.htm> から e-mail によるアラート配信として受信できます。まず、アラートにご登録後、My アラートにカスタマ変更通知が含まれるようにカスタマイズして下さい。これにより、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラッタ、アプリケーション ノートなどに関するアラートを受け取ることができます。登録方法は、[ザイリックスアンサー 18683](#) を参照して下さい。

お問い合わせ

ご不明な点、ご質問等ございましたら [ザイリンクス テクニカル サポート](#) までお問い合わせ下さい。この変更に関する認定データは、RPT014 : 『Qualification and Technical Data for Mold Compound & Die-Attach Epoxy Material Conversion 』
<http://www.xilinx.co.jp/bvdocs/reports/rpt014.pdf> を参照して下さい。

XCN05011 v2.0 - XCN06018 による変更

この変更通知 XCN05011 は、弊社の品質アラート (XCN06018) : 『Bond Lift on Wirebonded Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages』<http://www.xilinx.co.jp/bvdocs/notifications/xcn06018.pdf> の影響を受け、v2.0 をリリースすることになりました。

XCN06018 で通知致しました技術上の問題により、ザイリンクスは該当パッケージを G770 シリーズのマイナー変更をしたモールド コンパウンドへ移行することになりました。表 3 に、該当するパッケージ (FT/FTG256 および FG/FGG400/456/484/676/900/1156) を示します。これらの特定パッケージに対する変更の適用は、2006 年 7 月から段階的に実施され、2006 年 11 月までに完了する予定です。

モールド コンパウンドの詳細につきましてはザイリンクス販売代理店までお問い合わせして下さい。

表 3 : XCN06018 の影響を受けるパッケージ

パッケージ タイプ	最初の混在出荷 デート コード	品質アラート リリース後の 混在出荷デート コード
FG/FGG 400/456/484/556/676/900/1156	0609	(開始) 0629
FT/FTG 256	0601	(開始) 0629

改訂履歴

次の表に、この通知の改訂履歴を示します。

日付	バージョン	変更内容
2005/8/29	1.0	初版リリース
2006/03/11	1.1	デジジー チェーンおよびメカニカル サンプルに関して該当製品に追加。 表 1 を更新。パッケージ タイプ、BG 352/432/560 および FG 680/860 を削除。ダイアタッチ エポキシ HQ パッケージの値を変更。モールド コンパウンドの VO パッケージの値を変更。 表 2 を更新。FG 256/320/... パッケージのデート コードを変更。パッケージ タイプ、BG 352/432/560 および FG 680/860 を削除。
2006/04/03	1.1.1	『Qualification and Technical Data for Mold Compound & Die-Attach Epoxy Material Conversion』(RPT014) を更新。
2006/08/07	2.0	品質アラート (XCN06018) : 『Bond Lift on Wirebonded Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages』のリリースにより変更が必要となったモールド コンパウンドのリファレンスを追加。 XCN05011 v2.0 - XCN06018 による変更 (3 ページ) および表 3 の追加

この通知は、英語版 (XCN05011、バージョン 2.0、2006 年 8 月 7 日発行) を翻訳したものです。